



2012年1月期 決算説明会

2012年 3月 8日
株式会社 SUMCO

見通しに関する注意事項



本資料は一般の株主及び投資家に対する情報提供を目的に作成されたものであり、いかなる法域においても、当社が発行する証券の勧誘を構成するものではありません。

本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、半導体市況、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。



■ 2011年度 決算の概要(連結)

1. 当社を取り巻く環境
2. 2011年度 業績(連結)
3. 営業利益増減分析
4. 収益基盤強化施策の効果(対2010年度)
5. バランス・シート
6. キャッシュ・フロー

■ 2012年度 業績予想(連結)

1. 事業環境
2. 2012年度 業績予想
3. 営業利益増減分析

■ A種種類株式の発行

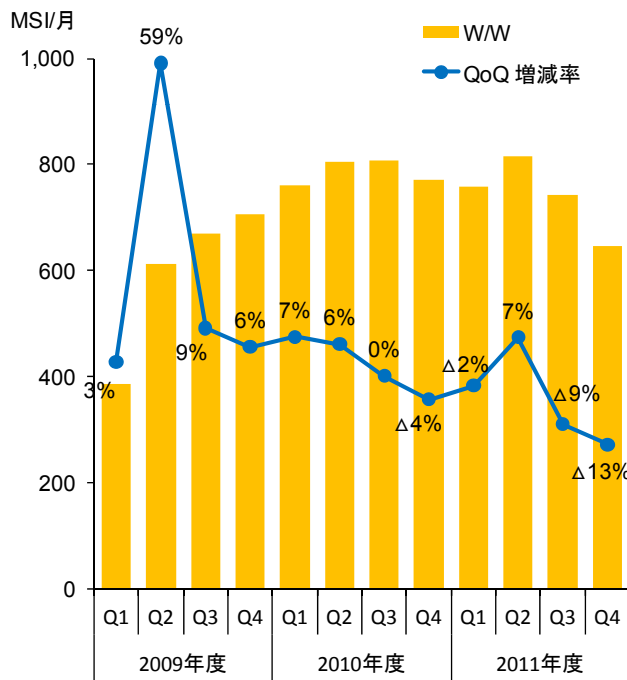
■ 参考資料



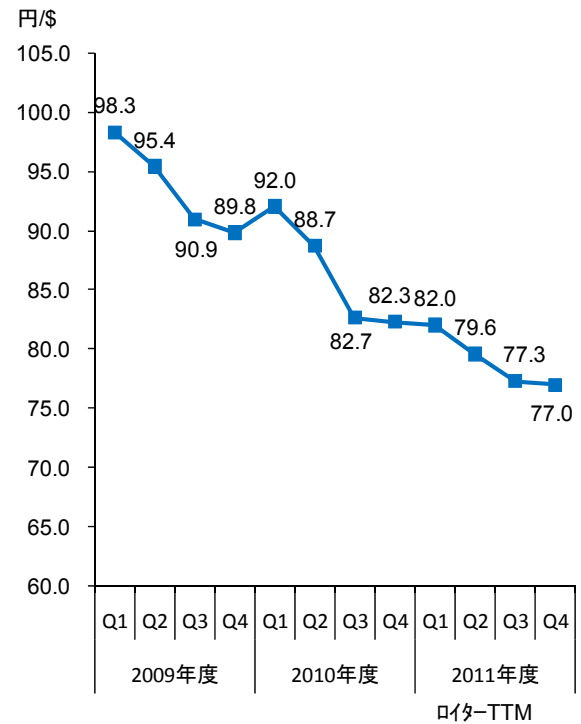
2011年度 決算概要(連結)

1. 当社を取り巻く環境

■ 半導体用シリコンウェーハ 世界出荷面積推移



■ 為替レートの推移



5

2. 2011年度 通期業績(連結)

■ 売上高 2,471億円、営業利益 9億円、純損失 843億円

(単位: 億円)

▼ 2011年度 連結業績

		2010年度 実績 ①	2011年度 実績 ②	増減 ②-①	単体 2011年度 実績
売上高		2,769	2,471	△ 298	2,073
営業利益		△ 84	9	93	25
営業外	減価償却費	△ 117	△ 33	84	△ 20
	その他	△ 60	△ 32	28	1
経常利益		△ 261	△ 56	205	6
特別損益		△ 230	△ 499	△ 269	△ 708
税金費用等		△ 164	△ 288	△ 124	△ 271
純利益		△ 655	△ 843	△ 188	△ 973
設備投資額(検収ベース)		103	220	117	
減価償却費		781	519	△ 262	
EBITDA (注)		610	523	△ 87	
為替レート(円/US\$)		87.5	79.9	△ 7.6	

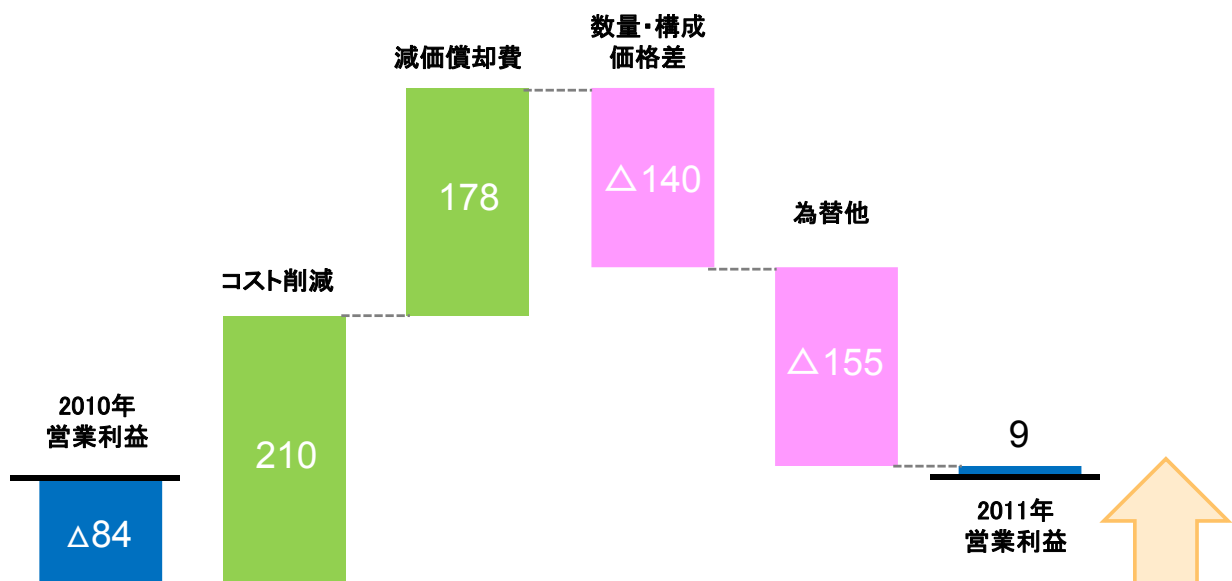
(注) EBITDA=営業利益+営業内減価償却費+のれん償却額

6

3. 営業利益増減分析(2010年 → 2011年)

■ 営業利益差異 +93億円

(単位:億円)



7

4. 収益基盤強化施策の効果(対2010年度)

■ 2011年度のコスト削減 226億円、減価償却費低減 246億円

(単位:億円)

	2011年度		2013年度 目標
	計画	実績	
固定費の削減	70	73	100
生産性の改善	116	153	290
合計	186	226	390

	2011年度		2013年度 目標
	計画	実績	
減価償却費の低減	195	246	300

8

5. バランスシート

■ 対前年度末、総資産 △1,253億円、負債 △360億円 (単位: 億円)

<連結>

<単体>

	2011年 1月末実績 ①	2012年 1月末実績 ②	増減 ②-①	2012年 1月末実績
現預金等	538	254	△ 284	193
有形・無形固定資産	2,918	2,124	△ 794	1,361
繰延税金資産	319	51	△ 268	0
その他	1,842	1,935	93	2,348
総資産	5,617	4,364	△ 1,253	3,902
有利子負債	2,648	2,350	△ 298	2,272
その他	808	746	△ 62	529
負債	3,456	3,096	△ 360	2,801
資本金・資本剰余金	2,033	2,033	0	2,033
利益剰余金	18	△ 826	△ 844	△ 961
その他	110	60	△ 50	29
純資産	2,161	1,267	△ 894	1,101
自己資本比率	35.0%	25.1%		
D/E レシオ(グロス)	1.3	2.1		
D/E レシオ(ネット)	1.1	1.9		

6. キャッシュフロー

■ 2011年度のキャッシュフローは営業キャッシュフロー +189億円、投資キャッシュフロー △175億円、フリーキャッシュフロー +14億円

(単位: 億円)

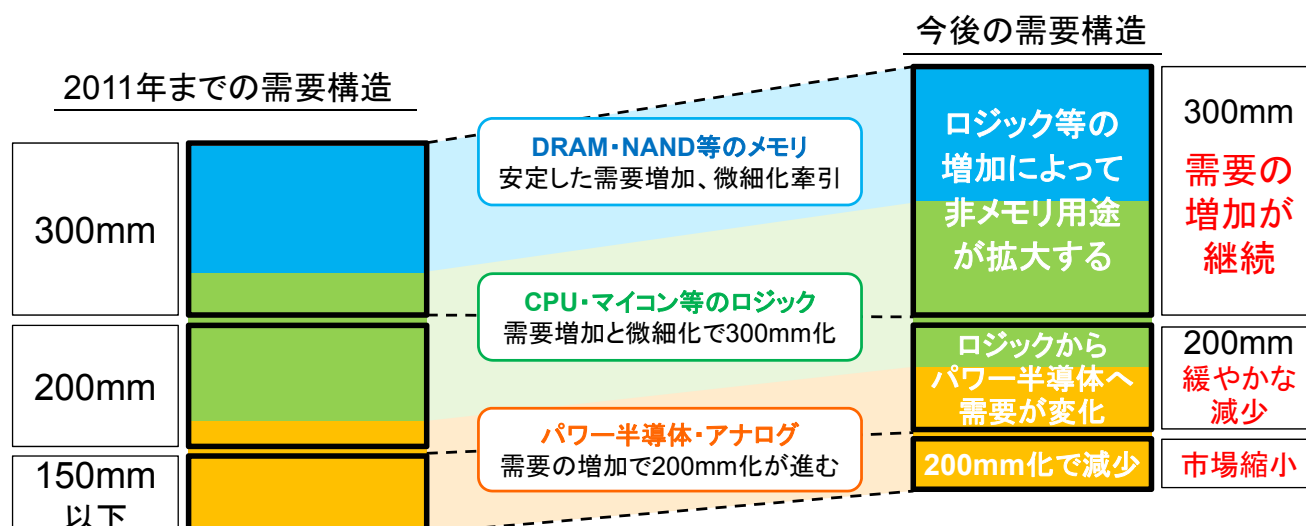
	2011年度 実績
税引前純損益	△ 556
減価償却費	519
事業再生計画費用	481
小計	444
運転資金等増減 他	△ 255
営業キャッシュフロー	189
設備投資(検収ベース)	△ 220
設備債務増減他	45
投資キャッシュフロー	△ 175
フリーキャッシュフロー	14
財務キャッシュフロー	△ 295
現預金残高	254
有利子負債残高	2,350

2012年度 業績予想(連結)

1. 事業環境の見通し



- 2012年度のシリコンウェーハ市場は、スマートフォンやタブレットなどの需要を下支えにして、需要は緩やかに回復すると見込む
- 300mmは、微細化対応製品の回復が比較的早い
- 200mm以下は調整が続くが、下期には緩やかに回復する
- 中期的には大径化しながら、シリコンウェーハの需要拡大は継続する



2. 業績予想(連結)

■ 売上高 2300億円、営業利益 150億円、純利益 30億円

▼ 2012年度 連結業績予想

(単位:億円)

	2011年度 実績 ①	2012年度 予想			増減 ②-①
		上期	下期	通期 ②	
売上高	2,471	1,080	1,220	2,300	△ 171
営業利益	9	40	110	150	141
営業外	減価償却費	△ 33	△ 1	△ 3	30
	その他	△ 32	△ 19	△ 37	△ 5
経常利益	△ 56	20	90	110	166
特別損益	△ 499	0	△ 50	△ 50	449
税金費用等	△ 288	△ 10	△ 20	△ 30	258
純利益	△ 843	10	20	30	873
設備投資額(検収ベース)	220	59	93	152	△ 68
減価償却費	519	164	177	341	△ 178
EBITDA (注)	523	210	294	504	△ 19
為替レート(円/US\$)	79.9	77.0	77.0	77.0	△ 2.9

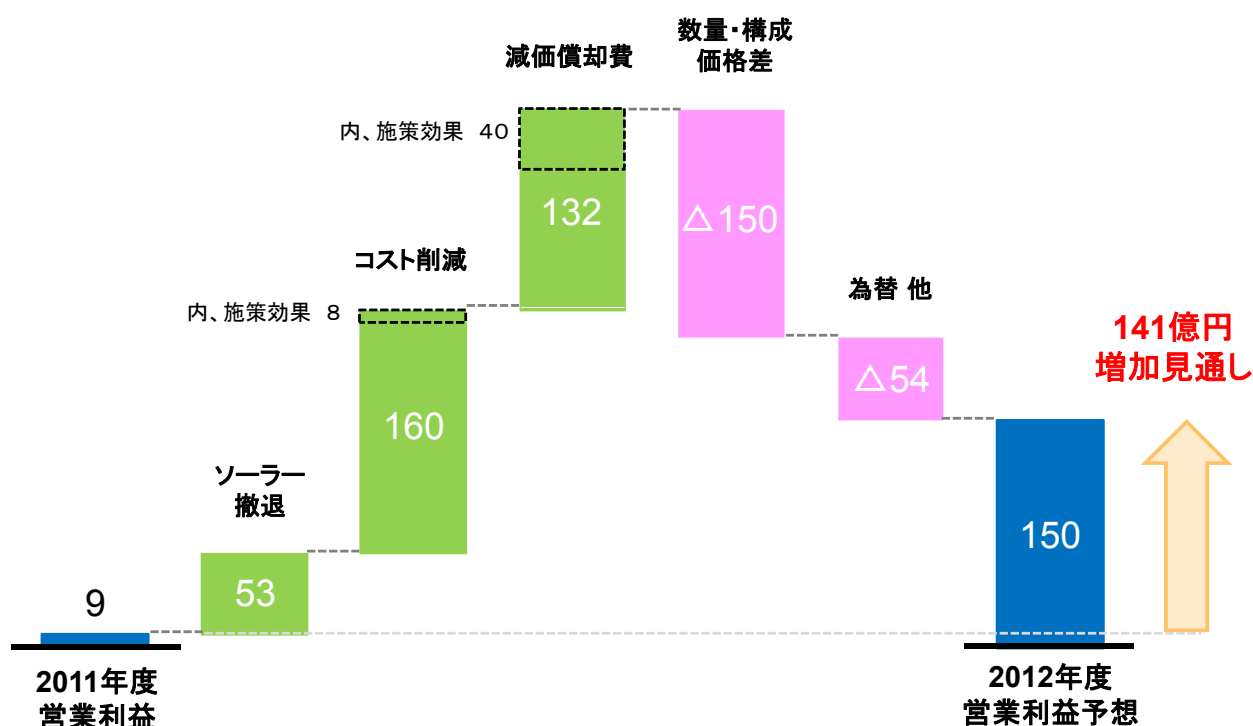
(注) EBITDA=営業利益+営業内減価償却費+のれん償却額

13

3. 営業利益増減分析(2011年 →2012年)

■ 営業利益差異 +141億円

(単位:億円)



14

A種種類株式の発行

1. A種種類株式発行の目的と特徴



■ 目的

- 本資金調達により、安定的な財務基盤を構築し、事業再生計画を着実に遂行

■ 特徴

- 普通株式への転換は3年経過以降に可能
- 普通株式への転換時の最大希薄化率 24.9%

2. A種種類株式の概要と日程

■ 概要

1. 発行総額 450億円
2. 引受先 住友金属工業株式会社殿
三菱マテリアル株式会社殿
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ
第壱号投資事業有限責任組合殿
3. 優先配当率 2.5%（累積型）

■ 発行日程

- 定時株主総会の決議 2012年 4月26日（予定）
- A種種類株式発行日 2012年 5月11日（予定）

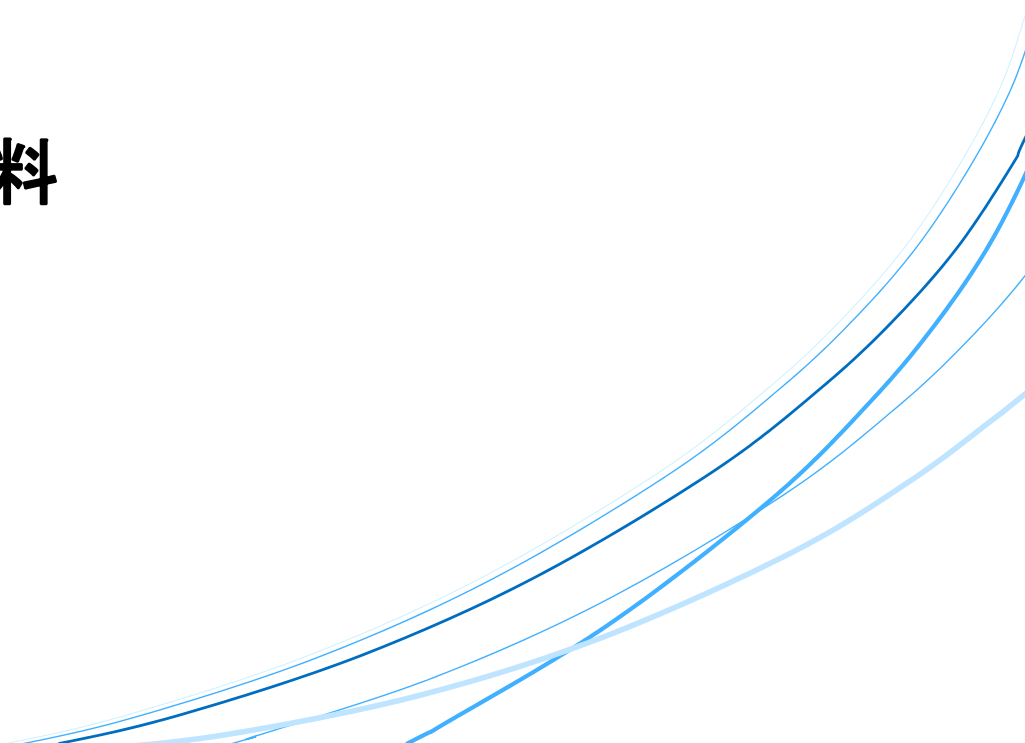
3. 増資後の純資産

- 自己資本比率は昨年度（2011/1末）水準の30%超に回復する見通し

（単位：億円）

	2011/1末 実績	2012/1末 実績	2012/1末 増資考慮後
総資産	5,617	4,364	4,814
純資産	2,161	1,267	1,717
自己資本比率	35%	25%	32%

参考資料



参考資料：特別損失と繰延税金資産取崩し



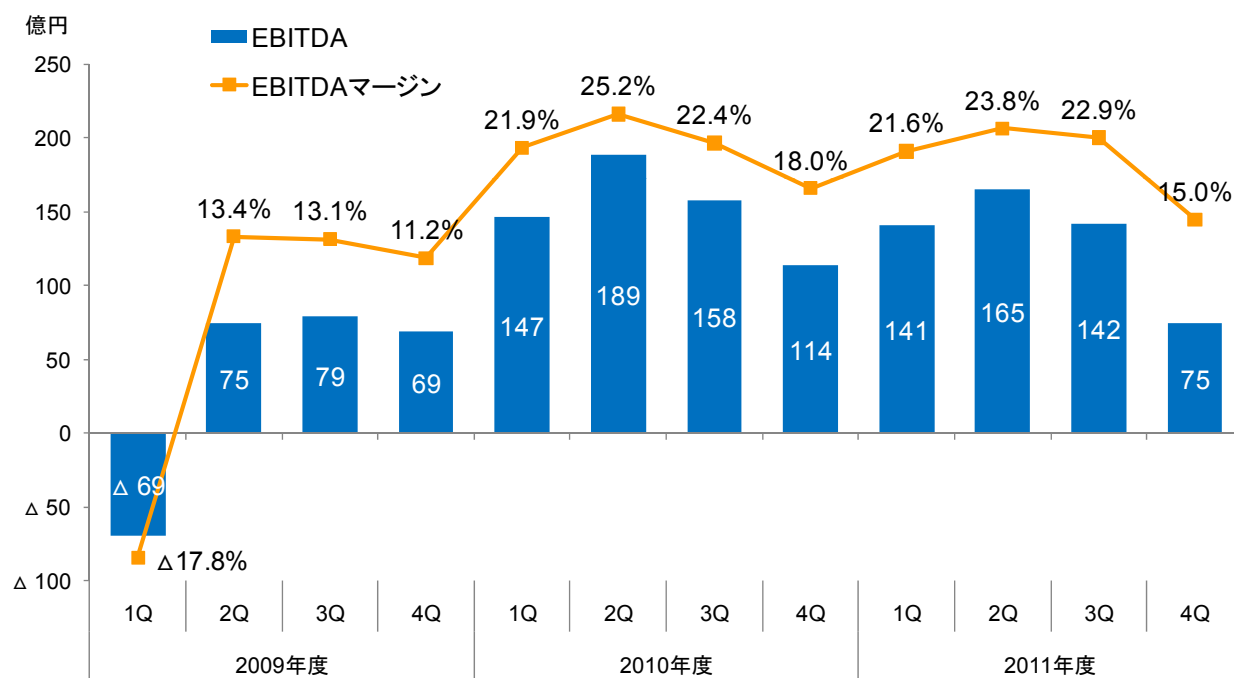
■ 特別損益を、連結で△499億円、単体で△708億円 計上

▼ 特別損益(連結)		(億円)
内 容	金額	
ソーラー関連	△ 169	
300mm関連	△ 112	
200mm関連	△ 44	
150mm関連	△ 12	
のれん償却額	△ 107	
その他	△ 37	
施策関連合計	△ 481	
震災損失・資産除去債務	△ 18	
特別損益	△ 499	

▼ 特別損益(単体)		(億円)
内 容	金額	
ソーラー関連	△ 120	
300mm関連	0	
200mm関連	△ 44	
150mm関連	△ 12	
その他	△ 37	
施策関連合計	△ 213	
関係会社株式評価	△ 477	
震災損失・資産除去債務	△ 18	
特別損益	△ 708	

■ 繰延税金資産取崩し 272億円

参考資料: EBITDA



(注) EBITDA＝営業利益＋営業内減価償却費＋のれん償却額

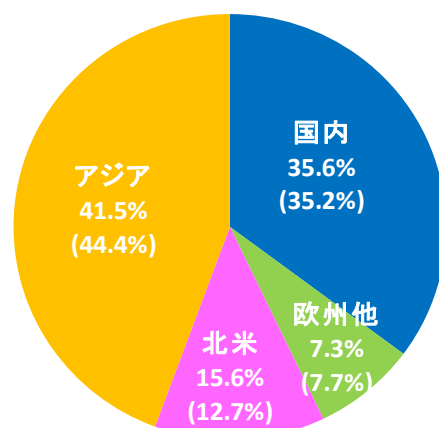
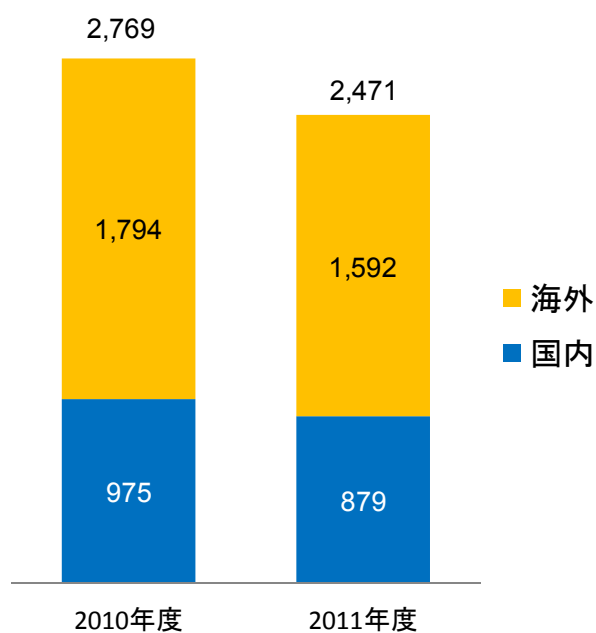
21

参考資料: 売上構成

国内外売上

地域別売上比率

(単位: 億円)



()内は前年同期実績

22



Developing Technology to Create the Future

